4H-SiC PiN ダイオードの順方向通電劣化における 基底面転位深さと積層欠陥拡大電流密度の関係

Relationship between basal-plane dislocation depth and stacking fault expansion current density in forward-current degradation of 4H-SiC PiN diode

(国研)産総研¹, (株)東レリサーチセンター², 昭和電工(株)³ ○林 将平^{1,2}, 山下 任^{1,3}, 先崎 純寿¹, 中山 浩二¹, 森塚 真由美¹, 米澤 喜幸¹, 加藤 智久¹, 児島 一聡¹, 奥村 元¹ AIST¹, Toray Research Center Inc.², SHOWA DENKO K.K.³ ○S. Hayashi^{1, 2}, T. Yamashita^{1, 3}, J. Senzaki¹, K. Nakayama¹, M. Morizuka¹, Y. Yonezawa¹, T. Kato¹, K. Kojima¹, H. Okumura¹ E-mail: Syohei Hayashi@trc.toray.co.jp

概要

4H-SiC バイポーラデバイスの順方向通電劣化について、これまでに我々は、エピ/基板界面より 基板側で貫通刃状転位(TED)に転換した基底面転位(BPD)を起源としてシングルショックレー型 積層欠陥(1SSF)が拡大することを明らかにした[1]。本研究では、BPD の TED 転換深さと 1SSF 拡 大電流密度の関係について議論する。

実験および結果

市販4°オフ4H-SiC基板Si面上にPiNダイオードを作製後、電流密度(J)150、600、1000、1250、1500、1750、2000Acm²を順に印加することで通電試験を行い、1SSF拡大の様子をエレクトロル ミネッセンスによりその場観察した。電極剥離後、フォトルミネッセンス、X線トポグラフィにより1SSF及び転位位置を特定し、1SSF拡大起点付近を走査透過型電子顕微鏡(STEM)により平面 および断面観察した。また、エピ/基板界面は走査型電子顕微鏡(SEM)により特定した。

Fig. 1 に、J = (a) 1000、(b) 1250、(c) 1500 Acm⁻² において拡大した 1SSF の起点付近における断面 STEM 像を示す。観察した 1SSF は全て BPD 方向とバーガースベクトルが並行な Screw 型 BPD を 拡大起源としており、平面 TEM 観察により特定した TED 位置において断面試料を作製した。ま た、Fig. 1(a)-(c)は、Fig. 1(d)に示すように各試料の SEM 観察により特定したエピ/基板界面(黄色点 線)を基準に並べた。J = 1000、1250、1500 Acm⁻²のストレス試験後において拡大した 1SSF の起源 となった BPD の TED 転換深さ(d)は、エピ/基板界面からそれぞれ d = 550、698、825 nm の位置に あることが分かった。この時、通電試験においてJ は段階的に増加させており、Fig. 1 に示す d =550、698、825 nm の場合、それぞれ 600-1000、1000-1250、1250-1500 Acm⁻² で 1SSF が拡大する BPD と考えられる。この結果を基に、 $d \ge 1$ SSF 拡大J の関係をJ = 550-600 Acm⁻² で 1SSF が拡大 した BPD の結果[1] と合わせて Fig. 2 に示す。その結果、d が深い程、高い J において 1SSF が拡 大することが明らかになった。これはJ の増加に伴い 1SSF 拡大を引き起こす臨界正孔密度がよ り深い位置にある BPD に到達可能となったためと考えられる。以上の結果から、Screw 型 BPD を 起源とした 1SSF の拡大においては BPD の転換深さが

1SSF 拡大Jに支配的に影響することが示された。 謝辞

本研究は、総合科学技術・イノベーション会議の SIP (戦略的イノベーション創造プログラム)「次世代パ ワーエレクトロニクス/SiC 次世代パワーエレクトロ ニクスの統合的研究開発」(管理法人:NEDO)によっ て実施された。本研究の一部は、九州シンクロトロン 光研究センタービームライン15(SAGA-LS/BL015)、 文部科学省委託事業ナノテクノロジープラットフォ ーム課題として、名古屋大学微細構造解析プラットフ ォームの支援を受けて実施された。

[1] S. Hayashi, et. al., Jpn. J. Appl. Phys. 57, 04FR07



Fig. 2. Dependence of current density at which 1SSF expansion occurs on BPD-TED conversion depth from epitaxial layer / substrate interface.



